



Brightening the Future
Since 1946

2024年度(2025年3月期) 第2四半期(中間期) 決算概要について

新光電気工業株式会社



目次

2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

決算概況	2
プラスチックパッケージ	6
メタルパッケージ	8
部門別売上高	10

2024年度 通期の見通し（連結）

業績予想の修正（10/25発表）	11
売上高・損益	12
設備投資額・減価償却費・研究開発費	14

JICC-04株式会社による当社株式に対する 公開買付け実施に向けた進捗状況等について（8/26発表）	15
--	----

2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

決算概況

（単位：億円）

	2023年度 中間期	2024年度 中間期	前年同期比		予想比	
				増減率	4/25予想	増減
売上高	1,051	1,083	+32	3%	1,150	△67
営業利益 （営業利益率）	115 (11%)	127 (12%)	+13	11%	160	△33
経常利益 （経常利益率）	141 (13%)	116 (11%)	△25	△18%	160	△44
純利益※ （純利益率※）	98 (9%)	82 (8%)	△16	△16%	110	△28

※ 親会社株主に帰属する中間純利益

1株当たり中間純利益	72.39円	60.80円
------------	--------	--------

2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

概況

- 半導体業界は、AI向けの需要拡大が継続するとともに、AI向けの設備投資を中心に半導体製造装置市場は堅調に推移した一方で、パソコン、汎用サーバー、自動車向け等が依然として低調のまま推移し、在庫調整長期化等の影響を受けるなど、半導体業界全体の本格的な回復には至らない状況が継続。
- 当社グループにおいては、セラミック静電チャックは半導体製造装置向けに受注が増加し、プラスチックBGA基板およびIC組立は、ハイエンドスマートフォン向け等に売上が増加。一方、フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けの需要回復の遅れや競争激化などの影響により、減収。
- 前年同期比で売上高3%増。利益面については、フリップチップタイプパッケージの減収や期後半における円高の進展による為替差損の計上等により、経常利益および純利益が減少。

2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

セグメント別売上高・経常利益

（単位：億円）

セグメント		2023年度 中間期		2024年度 中間期		前年同期比 増減率 (%)	2023年度	
			構成比(%)		構成比(%)			構成比(%)
売上高 ※1	プラスチックパッケージ	654	(62)	646	(60)	△1	1,278	(61)
	メタルパッケージ	354	(34)	396	(36)	12	739	(35)
	その他	43	(4)	42	(4)	△3	83	(4)
	合計	1,051	(100)	1,083	(100)	3	2,100	(100)
経常利益 ※2	プラスチックパッケージ	71	(11)	38	(6)	△47	118	(9)
	メタルパッケージ	80	(23)	88	(22)	11	161	(22)
	その他/調整額	△10		△11			△7	
	合計	141	(13)	116	(11)	△18	273	(13)

※1 外部顧客への売上高

※2 セグメント間取引調整前の経常利益

2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

財政状態、設備投資・減価償却費等

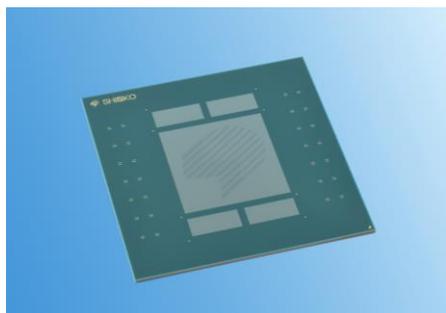
（単位：億円）

	2023年度 中間期 (2023年9月30日現在)	2024年度 中間期 (2024年9月30日現在)	2023年度 (2024年3月31日現在)
総 資 産	3,896	3,909	3,938
純 資 産	2,585	2,730	2,650
自己資本比率	66%	70%	67%

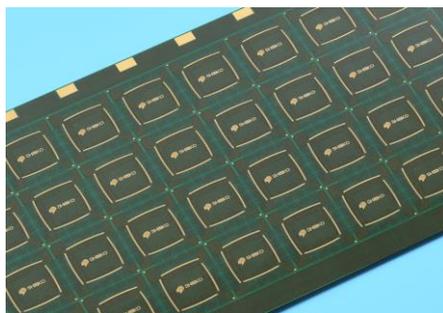
	2023年度 中間期	2024年度 中間期	2023年度
設備投資額※	215	124	637
減価償却費※	128	123	274
研究開発費	17	21	35
為替レート(1米ドル)	139円	150円	143円

※ 無形固定資産を除く

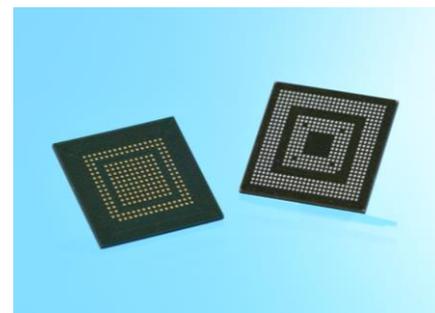
プラスチックパッケージ



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチックBGA基板



IC組立

【主な搭載製品例】

パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器 他

2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

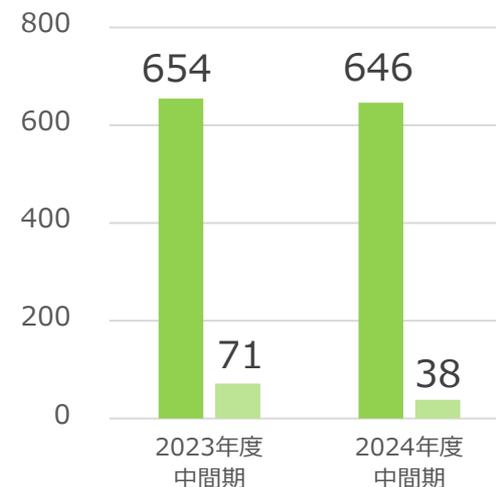
プラスチックパッケージ

（単位：億円）

	2023年度中間期	2024年度中間期	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	654 (62%)	646 (60%)	△8	△1%
経常利益（経常利益率）	71 (11%)	38 (6%)	△34	△47%

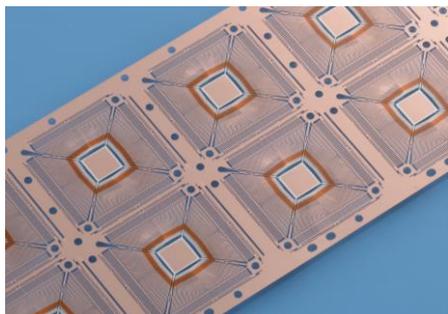
■ 売上高 ■ 経常利益

- フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けの需要回復の遅れや競争激化の影響などにより減収
- プラスチックBGA基板およびIC組立は、ハイエンドスマートフォン向け等に売上が増加

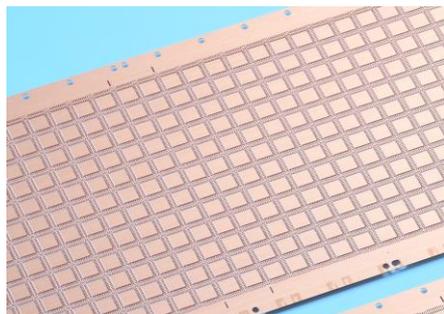


2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

メタルパッケージ



プレスリードフレーム



エッチングリードフレーム
(QFNタイプ)



セラミック静電チャック



ガラス端子



ヒートスプレッダー

【主な搭載製品例】

自動車、スマートフォン、民生機器、半導体製造装置、通信機器 他

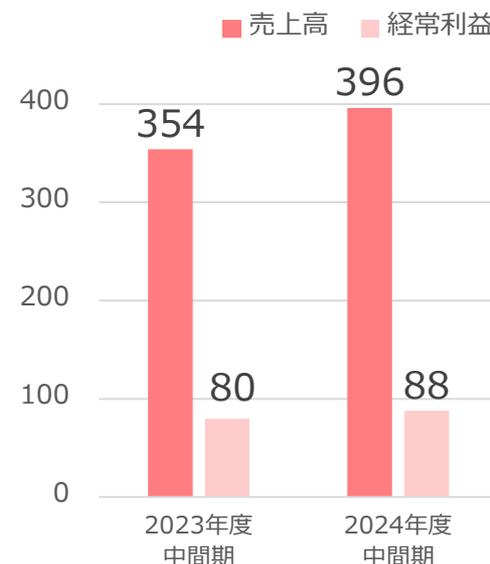
2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

メタルパッケージ

（単位：億円）

	2023年度中間期	2024年度中間期	前年同期比	
				増減率
売上高（構成比）	354（34%）	396（36%）	+42	12%
経常利益（経常利益率）	80（23%）	88（22%）	+9	11%

- セラミック静電チャックは、半導体製造装置向けに受注が増加
- ガラス端子は光学機器向けに売上が増加
- リードフレームは自動車向け等の在庫調整の影響を受けたものの、QFNタイプの受注増加などにより売上は前年並み
- CPU向けヒートスプレッダーは、パソコン、サーバー向けの受注が低調に推移し減収



2024年度 第2四半期（中間期）決算概要（連結）

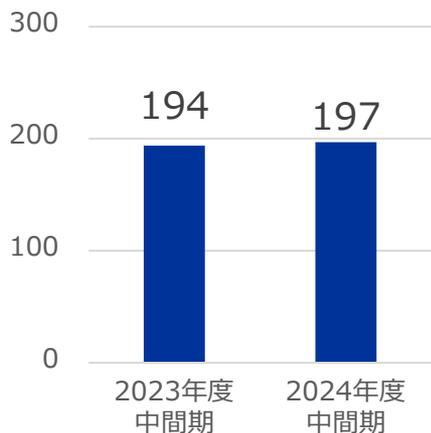
部門別売上高

（単位：億円）

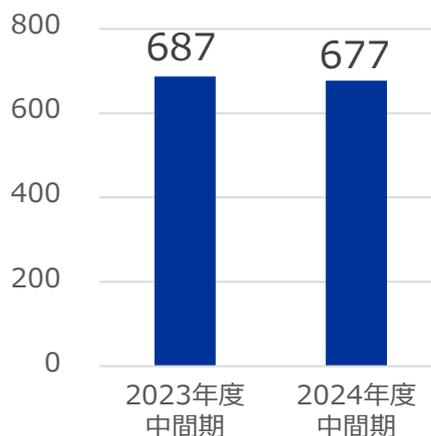
	2023年度 中間期	2024年度 中間期	前年同期比		2023年度
				増減率	
ICリードフレーム	194 (19%)	197 (18%)	+3	2%	389 (18%)
ICパッケージ	687 (65%)	677 (63%)	△10	△1%	1,336 (64%)
気密部品	170 (16%)	209 (19%)	+39	23%	375 (18%)

※（ ）は構成比

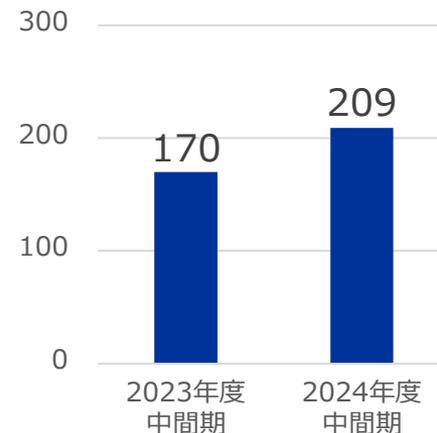
ICリードフレーム部門売上高



ICパッケージ部門売上高



気密部品部門売上高



2024年度 通期の見通し（連結）

業績予想の修正（2024年10月25日発表）

（単位：億円）

	第2四半期累計期間				通期			
	前回予想 (2024/4/25)	実績	増減額	増減比	前回予想 (2024/4/25)	今回予想 (2024/10/25)	増減額	増減比
売上高	1,150	1,083	△67	△6%	2,500	2,433	△67	△3%
営業利益	160	127	△33	△20%	440	407	△33	△8%
経常利益	160	116	△44	△28%	450	405	△45	△10%
純利益※	110	82	△28	△25%	300	272	△28	△9%
1株当たり中間 (当期)純利益	81.41円	60.80円	－	－	222.03円	201.31円	－	－

※親会社株主に帰属する中間（当期）純利益

● 第2四半期累計期間修正理由

- フリップチップタイプパッケージは、パソコン、サーバー向けの受注が低調に推移するとともに競争激化の影響を受け、リードフレームは自動車向けを中心に在庫調整が継続し、プラスチックBGA基板は先端メモリー向けの受注が想定比低水準にとどまるなど、売上は想定を下回った。利益面についても、売上高減少の影響を大きく受け、また、期後半における円高の進展による為替差損の計上などにより想定を下回った。

● 通期修正理由

- 第2四半期連結累計期間の売上高、各利益が予想を下回ったため、通期業績予想数値を修正。

2024年度 通期の見通し（連結）

売上高・損益

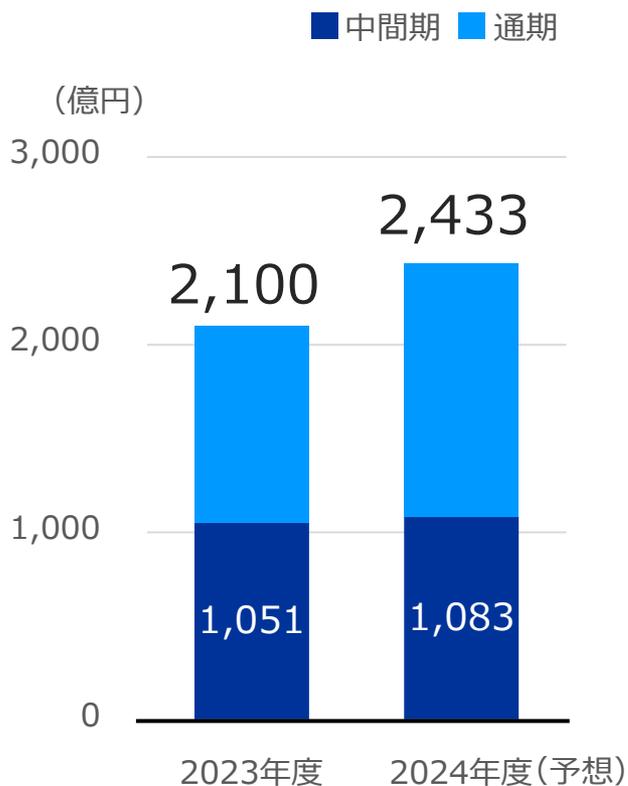
（単位：億円）

	2023年度（実績）			2024年度 （上期実績・下期予想）			前年同期比（上段：増減金額、下段：増減比率）		
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	上期	下期	通期
売上高	1,051	1,049	2,100	1,083	1,350	2,433	32 (3%)	301 (29%)	333 (16%)
営業利益 (営業利益率)	115 (11%)	133 (13%)	248 (12%)	127 (12%)	280 (21%)	407 (17%)	13 (11%)	146 (110%)	159 (64%)
経常利益 (経常利益率)	141 (13%)	132 (13%)	273 (13%)	116 (11%)	289 (21%)	405 (17%)	△25 (△18%)	157 (119%)	132 (49%)
純利益※ (純利益率※)	98 (9%)	88 (8%)	186 (9%)	82 (8%)	190 (14%)	272 (11%)	△16 (△16%)	102 (115%)	86 (46%)
為替レート	143円/\$			150円/\$	135円/\$				

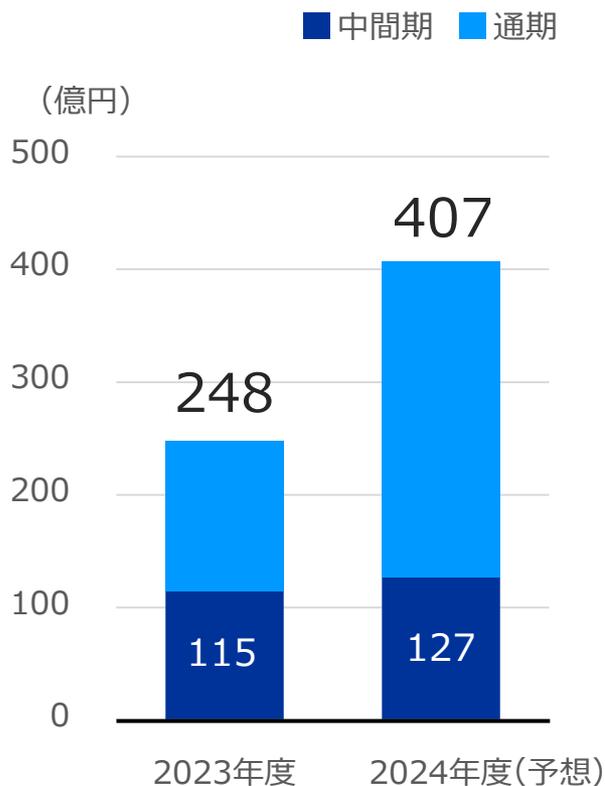
※ 親会社株主に帰属する当期純利益

2024年度 通期の見通し（連結）

売上高

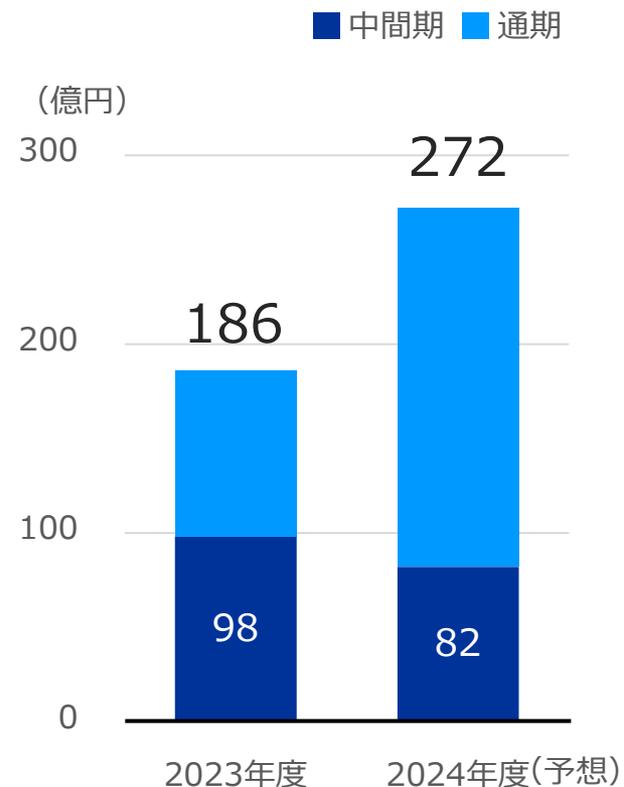


営業利益



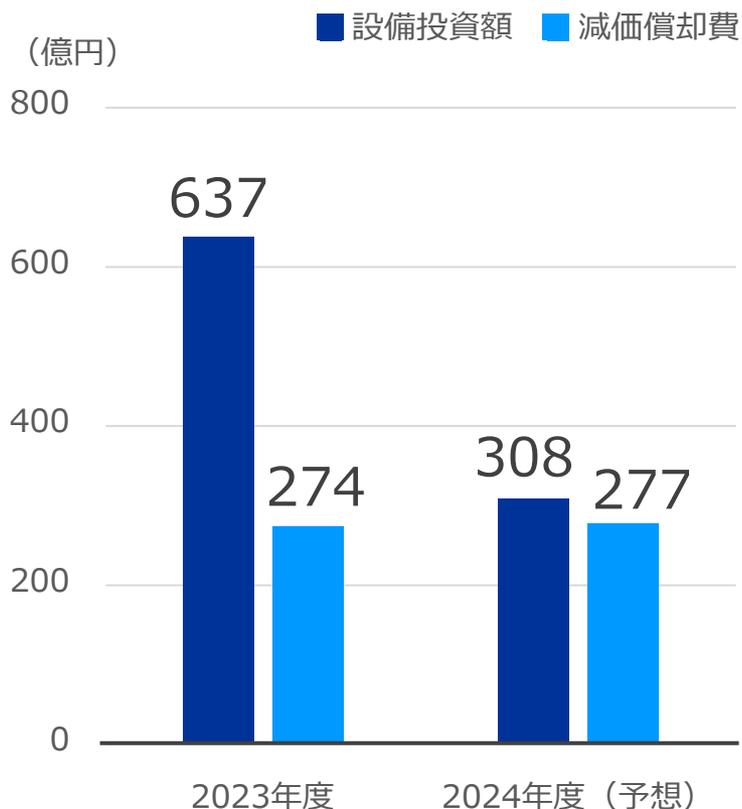
純利益※

※親会社株主に帰属する中間（当期）純利益

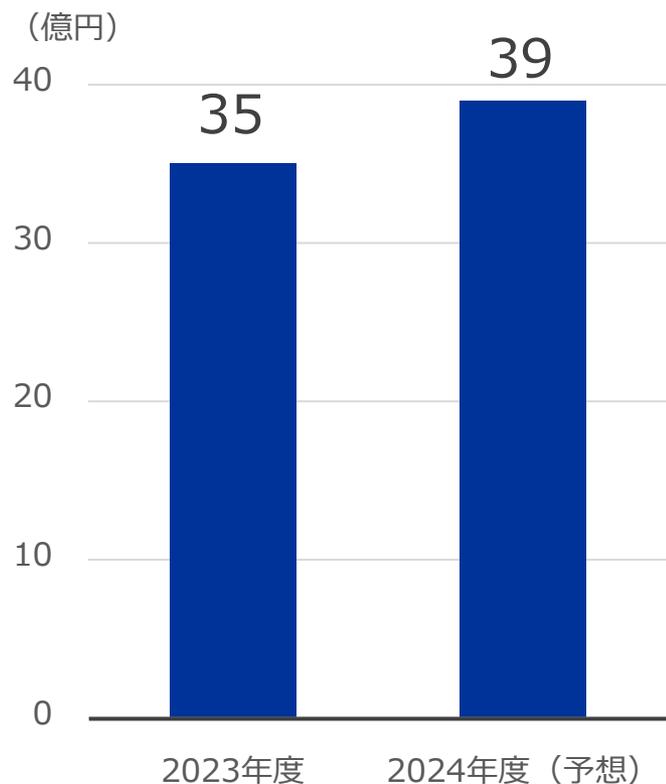


2024年度 通期の見通し（連結）

設備投資額・減価償却費



研究開発費



J I C C - 0 4 株式会社による 当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況等について

当社は、本件の進捗状況等について2024年8月26日に下記のとおり公表しております。

(開示事項の経過) J I C C - 0 4 株式会社による当社株式（証券コード 6967）に対する 公開買付け実施に向けた進捗状況等のお知らせ

当社は、2023年12月12日付プレスリリース「J I C C - 0 4 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」（その後の訂正内容を含む。）において、J I C C - 0 4 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）によれば、公開買付者による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、公開買付者が、国内外の競争法及び国外の投資規制法令等に基づく必要な手続及び対応が完了すること等一定の条件を前提条件として本公開買付けを開始することを予定している旨及び2024年8月下旬を目途に本公開買付けを開始することを目指している旨を公表しておりました。

公開買付者は、本公開買付けの実施に向けて、上記手続及び対応を進めているとのことですが、当社は、公開買付者より、2024年8月26日現在、日本、韓国、ベトナム及び中国の競争法に基づく必要な手続及び対応のうち、ベトナム及び中国において競争法に基づく必要な手続及び対応が完了していない旨の連絡を受けました。公開買付者としては、これらの競争法に基づく必要な手続及び対応が完了し、本公開買付けが開始される時期は、2025年1月下旬以降となることを見込んでおり、引き続き早期にこれらの手続及び対応を完了すべく努めるとのことです。

なお、公開買付者としては、今後については、本公開買付けのスケジュールが決定次第、その詳細をお知らせするが、2025年2月下旬においても、本公開買付けが開始される見込みがない場合においては、改めて進捗状況及び本公開買付けの開始見込時期をお知らせするとのことです。

今後については、公開買付者より本公開買付けのスケジュールを決定した旨の連絡を受けた場合には、速やかにお知らせいたします。

また、公開買付者によれば、公開買付者は、本公開買付けに係る公開買付代理人としてみずほ証券株式会社を起用する予定ですが、みずほ証券株式会社は、復代理人として楽天証券株式会社を選任する予定とのことですので、あわせてお知らせいたします。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報および合理的と判断する一定の前提に基づくものであり、将来の予想数値の実現を保証するものではありません。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

また、本資料では、業績の概略として多くの数値は億円単位にて表示しております。決算短信等で百万単位で開示しております数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信等を参照していただきますようお願いいたします。